PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-220637

(43) Date of publication of application: 14.08.2001

(51)Int.CI.

C22C 21/00 C22C 21/16 C25D 11/04 H01L 21/205 H01L 21/3065 // HO5H 1/46

(21)Application number : 2000-026892

(71)Applicant : KOBE STEEL LTD

(22)Date of filing:

04.02.2000

(72)Inventor: TANAKA TOSHIYUKI

WADA KOJI

HISAMOTO ATSUSHI

(54) ALUMINUM ALLOY FOR ANODIC OXIDATION TREATMENT, ALUMINUM ALLOY MEMBER HAVING ANODICALLY OXIDIZED FILM AND PLASMA TREATING SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an aluminum alloy for anodic oxidation treatment excellent in heat cracking resistance and corrosion resistance in a high temperature corrosive environment or moreover capable of realizing the excellent reduction of contamination and to provide an aluminum alloy member having an anodically oxidized film or the like. SOLUTION: This aluminum alloy for anodic oxidation treatment contains, by weight, 0.1 to 2.0% Si, 0.1 to 3.5% Mg, 0.02 to 4.0% Cu, and the balance Al with impurity elements. Among the impurity elements, preferably, the content of Fe is controlled to ≤0.1%, Cr to≤0.04% and Mn to ≤ 0.04%, and furthermore, the total of the impurity elements other than Fe, Cr and Mn is preferably controlled to ≤0.1%. Moreover, the aluminum alloy member in this invention is the one obtained by depositing an anodically oxidized film on the surface of a base material composed of the above alloy. This invention is suitably utilized for various members used in a high temperature corrosive environment, particularly, in high temperature corrosive gas and plasma environments.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号 特開2001 — 220637 (P2001 — 220637A)

(43)公開日 平成13年8月14日(2001.8.14)

		絶 知(記) 基	FΙ				ī	-マコード(参考)
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	C 2 2 C	21/00			С	5 F 0 O 4
C 2 2 C			0220	21/16				5 F O 4 5
	21/16		C 2 5 D				E	
C 2 5 D	11/04		U - U -	•			_	
H01L	21/205		H01L				Α	
	21/3065		H05H			٠,	-	最終頁に続く
	•	審査請求	未請求 請求	求項の数	5 OL	(主	0 貝)	奴隷気に加く
(21)出願番	号	特願2000-26892(P2000-26892)	(71)出願		01199 会社神戸	製鋼所	fi	
(22) 出顧日		平成12年2月4日(2000.2.4)	(72)発明 (72)発明 (74)代理	兵庫中年 日本	県神戸市 駅神戸市 県神戸市 会社神戸 計 発司 に は、	下中央区 下包第 下包第 下包第 下面区 下包第	\$ 操令 1 新神戸網 第 場合 1 新神戸網 第 場合 1 新神戸網	了1 丁目 3 番18 ⁹ 1 丁目 5 番 5 号 総合技術研究所 1 丁目 5 番 5 号 総合技術研究所

(54) 【発明の名称】 陽極酸化処理用アルミニウム合金、陽極酸化皮膜を有するアルミニウム合金部材およびプラズマ 処理装置

(57)【要約】

【課題】 高温腐食環境下において、耐熱割れ性および 耐食性に優れ、あるいはさらに優れた低汚染化を実現す ることができる陽極酸化処理用アルミニウム合金、陽極 酸化皮膜を有するアルミニウム合金部材等を提供する。 【解決手段】 本発明の陽極酸化処理用アルミニウム合 金は、wt%で、Si:0.1~2.0%、Mg:0.1~3.5%、Cu:0.02~4.0%、残部Alおよ び不純物元素からなる。不純物元素の内、Fe:0.1 %以下、Cr: 0. 04%以下、Mn: 0. 04%以下 とすることが好ましく、さらにはFe、Cr、Mn以外 の不純物元素の総和を0.1%以下に止めることが好ま しい。また、本発明のアルミニウム合金部材は、前記合 金からなる基材の表面に陽極酸化皮膜が形成されたもの である。本発明は、高温腐食環境下、特に高温腐食ガス やプラズマ雰囲気下で使用される各種部材に好適に利用 することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 化学組成がwt%で、Si:0.1~2. 0%, Mg: 0, $1\sim3$, 5%, Cu: 0, $02\sim4$. 0%、残部A1を本質的成分として含有し、その他不純 物元素からなる、陽極酸化処理用アルミニウム合金。 【請求項2】 不純物元素の内、Fe:0.1%以下、 Cr: 0.04%以下、Mn: 0.04%以下である、 請求項1に記載した陽極酸化処理用アルミニウム合金。 【請求項3】 Fe、Cr、Mn以外の不純物元素の総 和が0.1%以下である、請求項2に記載した陽極酸化 10 処理用アルミニウム合金。

【請求項4】 請求項1、2または3に記載したアルミ ニウム合金からなる基材の表面に陽極酸化皮膜が形成さ れた、陽極酸化皮膜を有するアルミニウム合金部材。 【請求項5】 真空チャンバ内でプラズマあるいはプラ ズマ化することによって得られる活性種によって被処理 物に所定の処理を施すプラズマ処理装置であって、 前記真空チャンバおよびその内部に設けられる部品のう ちの1種以上が請求項2または3に記載したアルミニウ ム合金からなる基材の表面に陽極酸化皮膜が形成された 20 アルミニウム合金部材によって構成された、陽極酸化皮 膜を有するアルミニウム合金部材を備えたプラズマ処理

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、陽極酸化処理に適 したアルミニウム合金およびこのアルミニウム合金によ って形成された基材の表面に陽極酸化皮膜が形成された アルミニウム合金部材に関し、これらの合金、部材は高 温腐食環境下での耐熱割れ性や耐食性が要求される種々 の用途、例えば半導体や液晶の製造設備などのプラズマ 処理装置に用いられる真空チャンバ、そのチャンバの内 部に設けられる部品の材料として好適に利用される。 100021

【従来の技術】アルミニウム合金を基材として、その基 材の表面に陽極酸化皮膜を形成し、基材に耐食性、耐摩 耗性などを付与させる陽極酸化処理は、従来から頻繁に 行われてきた。例えば、半導体製造設備のプラズマ処理 装置に用いられる真空チャンバおよびその中に設置され る電極等の各種部品は、主にアルミニウム合金によって 40 形成されているが、無垢のアルミニウム合金のままでは 耐食性や耐摩耗性を維持することができないので、通 常、アルミニウム合金によって形成された基材に陽極酸 化処理を施して、その表面に陽極酸化皮膜が形成され る。その理由は、前記真空チャンバの内部では、シリコ ン・ウェハ等の被処理物に半導体製造の前処理工程や製 造工程において室温から200℃以上の高温環境下で様 々な種類の腐食性ガスやプラズマあるいはプラズマ化す ることによって得られる活性種によって所定の処理が行

部に設置されるプラズマ電極等の種々の部品も前記雰囲 気に曝され、無垢のアルミニウム合金のままでは耐食性 や耐摩耗性を維持することができないからである。

【0003】前記アルミニウム合金としては、主にA1 -Mg系合金(JISA5000系)、A1-Mg-Si 系合金(J I S A 6 0 0 0 系)が用いられているが、近年 になって、デバイスデザインルールの微細化、プラズマ の高密度化に対応するため、部材のさらなる高耐食性、 被処理物の低汚染化が求められるに至っている。

【0004】これらの要求を満足するため、陽極酸化処 理を施す基材の材料として高純度アルミニウム (A1: 99. 9wt%以上)や、また特開平10-88271号 公報に記載されているように、高純度のアルミニウム中 にSi、Mgを添加し、その他の不純物の総和を0.1 %以下としたアルミニウム合金が提案されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら のアルミニウム合金からなる基材に陽極酸化処理を施し た部材は、陽極酸化皮膜自身に起因する汚染をある程度 低減することができるが、いずれも室温から200℃以 上の高温の腐食性ガス、ブラズマ環境下では、基材アル ミニウム合金と陽極酸化皮膜との熱膨張率の差に起因し た膨張差を緩和することが出来ず、陽極酸化皮膜に割れ が発生し、発生した割れに沿って腐食が進展する。これ によって、部材の寿命が短くなるだけでなく、パーティ クルの発生を招来し、プラズマ処理における被処理物の 汚染原因となる。

【0006】本発明は、かかる問題に鑑みなされたもの で、高温腐食環境下において、耐熱割れ性および耐食性 30 に優れ、あるいはさらに優れた低汚染化を実現すること ができる陽極酸化処理用アルミニウム合金、陽極酸化皮 膜を有するアルミニウム合金部材等を提供しようとする ものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の陽極酸化処理用 アルミニウム合金は、請求項1に記載したように、化学 組成がwt%で、Si:0.1~2.0%、Mg:0.1 ~3.5%、Cu:0.02~4.0%、残部A1を本 質的成分として含有し、その他不純物元素からなるもの である。

【0008】この発明によれば、所定量のSiおよびM gの含有により析出物(Mg,Si)が時効により析出 し、このMg,Si の周りにCuが濃化した状態とな り、この状態で陽極酸化処理を施すことにより、陽極酸 化皮膜中のセル3重点に熱膨張率の差異を緩和するのに 十分な空隙が形成される。このため、高温環境において 陽極酸化皮膜における割れの発生が抑制、防止され、陽 極酸化皮膜の本来の耐食性が発揮されるようになり、耐 熱割れ性および耐食性に優れる。また、熱膨張差に起因 われるため、真空チャンバの内面や、真空チャンバの内 50 した割れに基づいて発生する腐食が防止されるため、腐

食生成物に起因した汚染を抑制、防止することができ

【0009】この発明において、請求項2に記載したよ うに、不純物元素の内、Fe:0、1%以下、Cr: 0. 04%以下、Mn:0.04%以下とすることが好 ましく、さらには請求項3に記載したように、Fe、C r、Mn以外の不純物元素の総和を0.1%以下に止め ることが好ましい。これによって、陽極酸化皮膜におけ る不純物元素量を低減することができ、皮膜自身に起因 する汚染も抑制することができ、優れた低汚染化を実現 10 することができる。

【0010】また、本発明のアルミニウム合金部材は、 請求項4に記載したように、請求項1、2または3に記 載したアルミニウム合金からなる基材の表面に陽極酸化 皮膜が形成されたものである。

【0011】この発明によれば、基材と陽極酸化皮膜と の熱膨張差が緩和され、高温環境において陽極酸化皮膜 における割れの発生が抑制、防止され、陽極酸化皮膜の 本来の耐食性が発揮されるようになり、耐熱割れ性およ が防止されるため、低汚染化を実現することができる。 【0012】また、本発明のプラズマ処理装置は、請求 項5に記載したように、真空チャンバ内でプラズマある いはプラズマ化することによって得られる活性種によっ て彼処理物に所定の処理を施すプラズマ処理装置であっ て、前記真空チャンバおよびその内部に設けられる部品 のうちの1種以上が請求項2または3に記載したアルミ ニウム合金からなる基材の表面に陽極酸化皮膜が形成さ れたアルミニウム合金部材によって構成されたものであ る。

【0013】このプラズマ処理装置によれば、真空チャ ンバおよびその内部に設けられる部品のうちの1種以 上、すなわち真空チャンバ、あるいは真空チャンバ内に 設けられる部品の1種以上、あるいはこれらの両者が請 求項2または3に記載したアルミニウム合金からなる基 材の表面に陽極酸化皮膜が形成されたアルミニウム合金 部材によって構成されるので、当該部材は真空チャンバ 内の高温腐食性ガス、プラズマ等の雰囲気下において優 れた耐熱割れ性、耐食性を有し、また陽極酸化皮膜自身 に起因する不純物元素による汚染をも低減することがで 40 きるため、被処理物に対して優れた低汚染化を実現する ことができ、製造歩留まりが向上する。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明者らは、室温から200℃ 以上の高温腐食環境下において、耐熱割れ性および耐食 性が良好でしかも低汚染化を実現することができる陽極 酸化皮膜を有するアルミニウム合金部材を実現すべく。 鋭意研究を行った結果、基材を形成するアルミニウム合 金中の添加元素成分と陽極酸化皮膜の耐食性との間に相

形成する添加元素成分としてSi、Mg、Cuを見出し た。すなわち、Si、Mgのみを添加したアルミニウム 合金あるいはJISAIOOO系のような高純度アルミ ニウム材を基材として陽極酸化皮膜を形成した部材で は、室温から200℃以上の高温腐食ガス環境下ではそ の陽極酸化皮膜に熱による割れが発生し、割れに腐食性 ガスが侵入することにより基材が腐食してしまうため、 陽極酸化皮膜の持つ本来の耐食性を発現できず、また腐 食生成物によるパーティクルが発生した。ところが、S i、Mg以外にCuを適量添加することにより、その陽 極酸化皮膜に割れが入らず、このため基材に腐食性ガス が接触しないようになるため、高温において優れた耐食

性を発現させることでき、引いてはパーティクルの発生

が抑制できることを見出した。

【0015】基材中に存在するMg、Si、Cuが陽極 酸化皮膜の耐食性に効果を発揮するメカニズムについて は現在鋭意調査中であるが、基材中に析出するMg,S i の周りにCuが濃化した状態で陽極酸化処理を施す ことにより、皮膜中のセル3重点に熱膨張率の差異を緩 び耐食性に優れ、さらには割れに基づいて発生する腐食 20 和するのに十分な空隙が形成されることを突き止めてい る。さらに、Mg、Si、Cuの元素が、陽極酸化処理 時に形成される1つ1つのセル自身に熱割れに対する抵 抗力を発現するような影響を与えているのではないかと 推察される。

> 【0016】さらにアルミニウム合金中の含有元素量に ついて鋭意検討した結果、化学組成がwt%で、Si: 0. 1~2.0%、Mg:0.1~3.5%およびC u:0.02~4.0%を本質的成分として含有するア ルミニウム合金を基材として、これに陽極酸化皮膜を形 30 成することにより、所望の耐熱割れ性、耐食性を付与で きることを見出した。従って、不純物元素であるFe、 Cr、Mnなど、その他の元素は皮膜自身に起因する汚 染を低減する上で含有量を低減しても耐食性を劣化させ ることはない。

【0017】本発明は、上記知見を基になされたもので あり、まず本発明のアルミニウム合金の成分限定理由に ついて説明する。成分の単位はwt%である。

[0018] Si: 0. 1~2. 0%

 $Mg: 0.1 \sim 3.5\%$

Si、Mgは、Mg,Si 析出物を時効により析出させ るのに必要な元素であり、Si: 0.1%未満、Mg: 0. 1%未満では析出物Mg,Si がほとんど形成され ないため、セル3重点に熱膨張を緩和するほどの空隙を 形成することができない。一方、Si:2.0%超、М g:3.5%超では粗大な晶出物、例えばMg,Si、 Al,Mg,(Al,Mg, Al,Mg,,)及び粗大なSi 析出相が形成され、これが陽極酸化皮膜中に残存して欠 陥となり、耐食性を劣化させる。

[0019]Cu:0.02~4.0%

関関係があることを突き止め、高耐食性陽極酸化皮膜を 50 CuはMg,Si の周りに濃化した状態で陽極酸化処理

を施すことにより、陽極酸化皮膜中のセル3重点に熱膨 張率の差異を緩和するのに十分な空隙を形成させる作用 を有する。0.02%未満ではかかる作用が過少であ り、一方4.0%を超えると皮膜の成長が大きく阻害さ れ、処理に長時間がかかる。また、長時間の処理中に皮 膜が電解液に溶解し、皮膜性状が不均一になる。このた め、Cuの下限を0.02%、好ましくは0.1%と し、その上限を4.0%、好ましくは0.15%とす る。

【0020】本発明のアルミニウム合金は上記Si、M 10 g、Cuおよび残部Alを本質的成分とし、その他不純 物によって形成されるが、不純物元素としてのFe、C r、Mnなど重金属がウェハ等の被処理物中に置換型不 純物の位置を占めると、接合リーク電流の増加など半導 体装置 (デバイス) の特性不良を引き起こすので、F e、Cr、Mnをそれぞれ0.1%以下、0.04%以 下、0.04%以下に止めるのがよい。これにより、陽 極酸化皮膜自身からの汚染量を抑えることができ、半導 体装置の特性不良を抑制し、製造歩留まりを向上すると とができる。

【0021】前記Fe、Cr、Mn以外にも、Ní、Z n、Ti、B、Ca、Na、Kなどの不純物元素の存在 が被処理物の汚染に影響を及ぼすことがあるため、低汚 染化の観点からこれらの不純物元素の総和が0.1%以 下に止めることが好ましい。

【0022】本発明のアルミニウム合金部材は、前記ア ルミニウム合金からなる基材の表面に陽極酸化皮膜が形 成されたものである。前記基材は、前記アルミニウム合 金の鋳塊を圧延、鍛造、押出等の適宜の塑性加工によっ て得たアルミニウム合金材を溶体化処理、時効処理を施 30 性およびガス耐食性を下記の基準によって評価した。 した後、適宜の形状に機械加工することによって製作し てもよく、あるいは前記アルミニウム合金材を所定の形 状に成形加工した後、溶体化処理、時効処理を施しても よい。溶体化処理、時効処理の条件としては、例えば通 常のT6処理である、溶体化処理515~550℃、水 冷、時効処理170℃×8hr、155~165℃×1 8 h r を行うことができる。このような基材に陽極酸化 処理を施すことで、基材の表面に耐熱割れ性、耐食性に 優れた陽極酸化皮膜が形成される。

解を行う条件、すなわら電解溶液の組成、濃度、電解条 件(電圧、電流密度、電流-電圧波形)などの条件を適 直選択して行えばよい。陽極酸化処理液については、 C, S, N, P, Bから選ばれる1種以上の元素を含有 する溶液で電解を行うことが必要であり、例えば、シュ ウ酸、ギ酸、スルファミン酸、リン酸、亜リン酸、ホウ 酸、硝酸あるいはその化合物、フタル酸あるいはその化 合物から選ばれる1種以上を含む水溶液を用いて行うこ とが有効である。陽極酸化皮膜の膜厚は特に制限されな

Ομπ 程度、より好ましくは1~50μπ程度が適当で ある。

【0024】前記アルミニウム合金部材は、髙温の腐食 性雰囲気下で使用される各種用途に適するが、特に高温 環境下で腐食性ガス、プラズマ、あるいはプラズマ化す ることによって得られる活性種に曝され、その一方で被 処理物に低汚染化が求められる半導体製造設備等に付設 されるプラズマ処理装置に用いられる真空チャンバおよ びその内部に設けられる電極等の部品として好適に使用

【0025】以下、実施例によって本発明をさらに具体 的に説明するが、本発明はかかる実施例によって限定的 に解釈されるものではない。

[0026]

【実施例】下記表1に記載した組成を有するアルミニウ ム合金を溶製し、鋳造により得られた鋳塊を切断し、面 削した後、均熱処理を施した。均熱処理後、45mm厚の 素材を熱間圧延により4mm厚の板材に圧延し、溶体化処 理後、通常のT6処理を施して供試合金板を得た。この 合金板より35×25mmの試験片を採取し、表面を面削 加工した後、陽極酸化処理を施した。陽極酸化処理に使 用した処理液および電解電圧を表1に示す。処理液の温 度は室温とし、所定の膜厚になるまで処理した。

【0027】以上のようにして製作された試料の耐熱割 れ性、耐ガス腐食性を評価するため、◎室温から250 ℃までの加熱冷却サイクルを5サイクル行う耐熱割れ性 試験、25%塩素-アルゴン混合ガス中、300℃で3 hr保持する耐ハロゲンガス腐食性試験を行い、高温熱 サイクルおよび腐食環境下での陽極酸化皮膜の耐熱割れ

の耐熱割れ性評価基準

◎:割れ無し

〇:割れ長さ80mm/10cm 未満

△:割れ長さ80mm/10cm 以上~160mm/10cm '未満

×:割れ長さ160mm/10cm²以上

②耐ガス腐食性評価基準

⑥:腐食発生無し

〇:腐食発生面積率10%未満

【0023】陽極酸化皮膜を形成する方法としては、電 40 △: 腐食発生面積率10%以上、20%未満

×:腐食発生面積率20%以上

【0028】また、試料No. 16~23については、皮 膜形成速度を測定し、Cu含有量の相違による陽極酸化 処理性を下記の基準に基づいて評価した。

· 陽極酸化処理性評価基準

O:20 µm/hr以上

△:8μm/hr以上,20μm/hr未満

×: 8 μm / h r 未満

【0029】上記耐熱割れ性、耐ガス腐食性および陽極 いが、0、 $1\sim200$ μ m 程度、好ましくは0、 $5\sim7$ 50 酸化処理性の評価結果を表1に併せて示す。なお、表1

7

の試料No.5のアルミニウム合金は市販のJISA6061アルミニウム合金に相当する。表1より、Si、MgおよびCuの含有量が本発明条件を満足している試料(No.1~10、No.18~22)については、良好な耐熱割れ性、耐ガス腐食性および陽極酸化処理性が得ら*

* れた。一方、C u 量が発明範囲超のNo. 2 3 は、耐熱割れ性、耐ガス腐食性は良好であったが、陽極酸化処理性の劣化が著しい。

[0030]

【表】】

	合金	成分	wt%	不能物元素 wt%			陽器酸化皮膜			耐熱	耐ガス	陽禮酸化	汚染に			
試料 No.	Si	Мв	Cu	Fo	C r	Min	その他 合計	電解溶液 種類:濃度g/I	電圧	典厚	割れ性	腐食性	处理性	対する 評価	#	考
	0.57	0. 55	D. 12	0.012	(0.005	<0.005	0.04	920酸: 30	80	20	0	0	未調査	0		
2	0.61	0.99	0.04	0.012	<0.005	<0.005	0.03	シュウ臓: 30	80	20	0	0	•	0		
3	0.63	0.95	D. 11	0.03	D. 018	0.02	0.12	シュウ酸: 30	8D	20	0	0		0		
4	1.0	0.8	D. 1	0.09	0.015	0.037	Q. 15	シュウ酸: 30	80	20	0	0	•	0		
5	0.74	0. 95	0.31	0.35	0.087	0,11	0.14	シュウ酸: 30	80	20	0	0	•	Δ		
6	0.8	0. 9	0.2	0.15	0.05	0.05	0.08	シュウ酸: 30	80	20	0	0		Δ		
7	1.4	2.0	0.4	0.2	0.01	0.01	0.05	シュウ酸: 30	80	20	0	0		Δ		
8	0.4	0.7	0.05	0.04	0.03	0.02	D. 1	硫酸 : 150	15	50	0	0		未開査		
9	0.1	0. 2	0.8	0.015	<d. 005<="" td=""><td><0.005</td><td>0.03</td><td>リン酸 : 30</td><td>80</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>*</td><td>•</td><td></td><td></td></d.>	<0.005	0.03	リン酸 : 30	80	5	0	0	*	•		
1 0	1.5	2.5	1.5	0.03	0. 02	0.02	0.05	シュク酸: 30 硫酸: 2	50	13	0	0	•	•		
1 1	0.6	0.75	0.01	0.015	0.01	0.008	0.03	シュウ酸: 30	80	20	×	Δ	-	*	比較	例
1 2	0.4	1.5	<u> ⟨0.01</u>	0.08	0.03	0.03	0.12	919酸: 30	80	15	×	×	"	-	比較	91
1 3	0.05	0.05	0.1	0.05	C. 032	0.02	0.88	929酸: 30 硫酸 : 2	50	15	×	×			比較	例
1.4	1.0	0.01	0.1	0.04	0.012	<0. DOS	D. 04	シュウ瞳: 30	80	18	×	×	. If	,	比較	例
1 5	<u>2.5</u>	1.0	0.2	0.02	<0.005	<0.008	0.01	99.9酸: 30 硫酸: 2	50	25		Δ	*	•	比較	例
1 6	0.6	1.0	⟨0.01	0.012	0.01	0.01	0.01	ショウ酸: 30	80	20	×	×	0_		比較	例
1 7	0.6	1.0		0.015	0.02	0.02	0.04	シュウ酸: 30	80	20	Δ	×	0	•	比較	8
1.8	0.6	1.0	0.02	0.02	0.012	0.01	0.05	ラコク酸: 30	60	20	0	0	0			
1 9	0.6	1.0	0.1	0.01	0.015		0.11	シュウ酸: 30	80	20	0	0	0			
2 0	0.6	1.0	0.5	0.02	<0.005	<0.005	0.08	シュウ醴: 30	80	20	0	0	0_			
	0.6	1.0	2.0	0.012	0.013	0.01	0.04	シュウ酸: 30	80	20	0	0	Δ	4		
2 2	0.6	1.0	4.0	0.01	0.014		0.12	シュウ酸: 30	80	20	0	0	Δ	#		
2 3	0.6	1.0	6.0	0.01	(0.005	<0.005	0.05	シュウ酸: 30	80	20	0	0	×		比較	Ø

【0031】次に、試料No. 1~7のアルミニウム合金 について、プラズマ処理装置により、基板処理における 汚染性を調べた。前記プラズマ処理装置用の真空チャン 30 バは、鋳塊を圧延してアルミニウム合金の厚板を製作 し、これに溶体化処理、時効処理(T6)を施した素材 から、 φ270 mm×100 mm深さの処理室を有する真空 チャンバ用基材を機械加工により製作し、これを表1と 同様の処理条件でその表面に20 µm の陽極酸化皮膜が 形成されたものである。この真空チャンバの開口部の上 にSiO、ガラスで形成された上蓋が気密に組み立てら れ、その上蓋の真上に高周波発生用アンテナが設置され た。この真空チャンバの内部に設けられた電極板の上に ϕ 150mmの基板(シリコン・ウェハ)を設置した。前 40 記電極板は前記真空チャンバ用基材と同材であり、同条 件にて20μmの陽極酸化皮膜が形成されたものであ る。また、真空チャンバには、その内部に連通する排気 管、ガス供給管が付設された。

(0032) プラズマ試験は、下記の条件でプラズマを発生させ、基板を腐食性ガスおよびプラズマに2hr曝した後、基板上のFe、Cr、Mnの総量を測定し、下記基準に基づいて基板の汚染度を評価した。

·試験条件

使用ガス:塩素ガス

ガス圧力: 10 mTorr ガス流量: 100 sccm

RFパワー: ICP 100₩ RF発生時間: 2hr (試験時間)

·基板污染度評価基準

試料NO.5のアルミニウム合金(市販の6061材に相当)による真空チャンバ(基準チャンバ)によってプラズマ処理した基板のFe、Cr、Mnの総量を100%として

◎: 基準チャンバの50%未満

○: 基準チャンバの50%以上80%未満

△: 基準チャンバの80%以上95%以下

【0033】その結果を上記表 1 に併せて示す。表 1 より、試料No. $1\sim7$ のアルミニウム合金のうち、 F e、 C r、 M n が本発明に規定する所定量以下とされたNo. $1\sim4$ は、基板の低汚染化が実現されている。もっとも、No. 4 はその他の不純物が0. 15%とやや多いために、汚染度は他のものに比してやや大きい。一方、 F e、 C r、 M n のいずれか 1 種でも発明範囲超である N o. $5\sim7$ は、耐熱割れ性および耐ガス腐食性は良好であるものの、No. $1\sim4$ に比して基板の低汚染化に劣る。

50 [0034]

特開2001-220637

10

【発明の効果】本発明のアルミニウム合金、アルミニウ ム合金部材によれば、耐熱割れ性、耐ガス腐食性に優れ た陽極酸化皮膜が得られ、引いては低汚染性をも兼備し たものとなり、高温腐食性ガス、プラズマ環境下におい* 向上させることができる。

* て好適に使用することができる。また、本発明のプラズ マ処理装置によれば、プラズマ処理において優れた低汚 染化を実現することができ、被処理物の製造歩留まりを

フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

// H 0 5 H 1/46

テーマコード(参考)

HO1L 21/302

FΙ

(72)発明者 久本 淳

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内 Fターム(参考) 5F004 AA16 BB29 BB30 5F045 BB14 EB03 EC05 EM09